

工业智能每日观察：Cadence 发布 Maestro：让芯片设计智能体从 EDA 求解结果中学习

中国高技术产业发展促进会新质生产力工作委员会

2026 年 10 月 27 日

摘要

10 月 26 日，Cadence 发布 Maestro 领域专用 AI 模型组合，把强化学习、EDA 求解器和芯片设计智能体接到一起。Oracle 在 Fusion Cloud SCM 中推出三类供应链智能体应用，分别处理稀缺资源分配、运输装载和采购支出分析。同日开幕的日本国际工作机械展 JIMTOF 2026 上，Okuma、CKD 和 Star Micronics 展示了自动化机床、装配数字孪生与加工软件，面向多品种小批量生产。几项发布分别从工程设计、供应链业务和车间现场切入。

Contents

一、Cadence 发布 Maestro：让芯片设计智能体从 EDA 求解结果中学习	2
二、Oracle 推出三类供应链智能体：从分析延伸到受控执行	2
三、JIMTOF 开幕：Okuma 展示两款五轴加工与自动换件新设备	3
四、CKD 与 Star Micronics 展示细分制造能力：装配数字孪生连接执行机构	3
趋势观察	4
参考资料	4

一、Cadence 发布 Maestro：让芯片设计智能体从 EDA 求解结果中学习

Cadence 于 10 月 26 日发布 Maestro AI Model Portfolio，为芯片和系统设计提供领域专用模型、决策模型以及可持续更新的 Agent 技能。Maestro 连接 AuraStack、ChipStack、InnoStack、ViraStack 等智能体产品，通过强化学习循环读取电子设计自动化（EDA）和系统设计自动化（SDA）工具的结果。Cadence 公布的早期工作流测试中，设计质量指标最高改善 30%，Token 使用效率最高提高 5 倍；这两项数字来自公司的特定测试。[1]

芯片设计建议要落地，还得经过专业工具检查功耗、时序、面积和制造规则。Maestro 让模型读取这些计算结果，再根据约束检查修正输出。平台支持云端部署，也支持由客户控制的本地部署，供处理敏感设计数据的半导体企业选择。Socionext 表示正把 InnoStack 引入生产设计环境，并对生产率提升提出预期。[1][2]

AI+CAE 和 AI+CAD 也会遇到类似问题：模型给出的建议，能否交给专业求解器验证，并回到设计对象和规则中继续修改？Maestro 提供了一种将这些环节接起来的做法。

二、Oracle 推出三类供应链智能体：从分析延伸到受控执行

Oracle 在 10 月 26 日的 AI World 活动上宣布，把新的 Fusion Claw 智能体应用加入 Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing。首批披露三个场景：Supply Planning Allocation 为短缺原料和产能计算跨订单分配方案；Shipment Load Planning 综合时效、装载空间、交付承诺和成本安排运输；Procurement Spend 分析采购支出、合同执行偏差与节约机会。[3]

应用使用现有 Fusion 系统中的产品、采购、计划和物流数据计算，再把推荐方案交给业务人员审阅和批准。遇到原料短缺，可以按不同客户优先级形成供应计划；运输能力紧张时，可以比较装载方式与服务承诺。要让这些建议进入实际业务，还得保证主数据准确、权限设置合适，以及 ERP/MES 中的业务状态一致。Oracle 目前公布的是功能范围，具体效果还要看后续客户应用数据。[3][4]

三、JIMTOF 开幕：Okuma 展示两款五轴加工与自动换件新设备

第 33 届日本国际工作机械展（JIMTOF 2026）于 10 月 26 日在东京国际展示场开幕，持续至 10 月 31 日。Okuma 展位以自动化、工序集成和 AI/智能化为三项解决方案，首次公开展示 MU-350V+AWC 五轴立式加工中心与 MU-250H+AWC 五轴卧式加工中心。现场还展示 ARMROID 机床内机器人、移动协作机器人 OMR20 和塔式自动托盘更换系统。[5][6]

两款新设备面向多品种、小批量零件加工。AWC 自动换件可在有限人工干预下连续处理不同工件；配合机床状态监测和刀具路径管理，有助于缩短换线时间。对于使用方，产线节拍和设备可用率比单项 AI 功能更容易测量。设备刚在展会亮相，产能、精度与回本周期仍要按客户零件和加工工况测算。

四、CKD 与 Star Micronics 展示细分制造能力：装配数字孪生连接执行机构

同一展会上，日本自动化元件企业 CKD 展示“数字组件与实体组件协同”的装配方案，覆盖机器人搬运、O 形圈安装、小零件装配、螺钉紧固和外观检测。展品还包括 3D 吸附手爪、快调机构及脉冲吹气节能元件。展位资料在 9 月预先公布，10 月 26 日进入实际展期。[7]

精密机床企业 Star Micronics 在日本首次展示 SB-12R，并现场加工面向人形机器人、医疗、无人机和电动车的示范零件。其 SMOOSS-i 软件覆盖机床状态可视化、加工计划、远程操作和程序管理；企业还展示了辅助断屑、去毛刺的加工循环软件。[8]

这些展品对应小型零部件加工企业的实际约束：场地和人员有限，订单却要求快速换型。除了整机自动化，软件还得处理零件、工序、夹具、刀具与执行机构之间的衔接。

趋势观察

Cadence 让模型读取设计求解结果，Oracle 把智能体放进供应链审批流程，机床厂商则在现场处理换型与工序衔接。三个环节的数据和约束各不相同。对中小制造企业，更可操作的起点是选定一条产线，把设备、工艺和质量数据先接通，再检验实际效果。

参考资料

1. Cadence 官网 | Cadence Introduces Maestro, a Domain-Specialized AI Model Portfolio to Revolutionize Agentic Chip and System Design | 2026-10-26 | 核验模型架构、性能测试、部署方式
https://www.cadence.com/zh_TW/home/company/newsroom/press-releases/pr/2026/cadence-introduces-maestro-a-domain-specialized-ai-model.html
2. Reuters | Cadence unveils suite of AI models that chipmakers can run in-house | 2026-10-26 | 独立核验 Maestro 与芯片设计市场背景
<https://www.reuters.com/business/cadence-unveils-nvidia-backed-ai-models-that-chipmakers-can-run-in-house-2026-10-26/>

3. Oracle 官网 | Oracle Introduces Claw-Powered Fusion Agentic Applications for Supply Chain | 2026-10-26 | 核验三类新应用、业务权限与执行机制
<https://www.oracle.com/it/news/announcement/ai-world-oracle-introduces-claw-powered-fusion-agentic-applications-for-supply-chain-2026-10-26/>
4. Oracle 官网 | Oracle Extends Fusion Agentic Applications with Introduction of Fusion Claw | 2026-09-29 (产品背景) | 解释既有执行环境与新供应链应用的关系
<https://www.oracle.com/fr/news/announcement/oracle-extends-fusion-agentic-applications-with-introduction-of-fusion-claw-2026-09-29/>
5. JIMTOF 主办方 | JIMTOF2026 開催概要 | 会期 2026-10-26 至 10-31 | 核验开幕日期、地点和主办方
<https://jimtof.org/jp/outline.html>
6. Okuma 官网 | JIMTOF 2026 新機種・ソリューション | 2026-10-26 展期 | 核验首次展示机型、自动化与智能化内容
<https://www.okuma.co.jp/event/jimtof/2026/>
7. CKD 官网 | JIMTOF2026 / Tokyo Big Sight | 2026-09-23 预告、2026-10-26 展出 | 核验装配数字孪生、机器人与元件方案
<https://www.ckd.co.jp/en/event/jimtof2026/>
8. Star Micronics 官网 | JIMTOF2026 特设网站 | 2026-10-26 展期 | 核验 SB-12R 日本首展及 SMOOSS-i 软件
<https://star-m.jp/jimtof2026/>